

# CERASIC®-Bの接合技術

## CERASIC-B Bonding Porous SiC Technology

当社独自の接合技術により、CERASIC®-B とCERASIC®-B の接合やCERASIC®-B とCERASIC®-BPの接合が可能となり、中空構造や多孔体機能を必要とする部材への適用が可能です。

このため、CERASIC®-Bの高熱伝導率性を生かした水冷構造を持つ部品や多孔体と緻密質との複合材料部品の作製も可能で、あらゆるニーズに対応します。

With our unique bonding technology, it is possible to bond CERASIC-B and CERASIC-B or CERASIC-B and CERASIC-BP, which can be applied to parts with a hollow structure or porous function.

Therefore, parts with a water-cooled structure that utilize the high thermal conductivity of CERASIC-B and composite material parts with a porous and dense body can be produced. Based upon these technologies, Covalent Materials meets your needs.

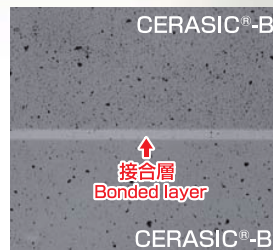
### 特長 Features

- 接合可能寸法: 1200mm  
Sealable dimensions: 1200mm
- 接合部曲げ強さ: 200Mpa(25℃)  
Seal bending strength: 200Mpa(25℃)

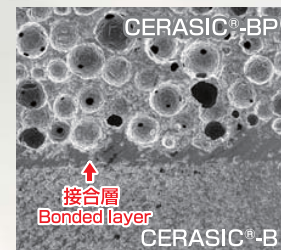
### 接合層 Bonded layer



中空構造体モデル  
Hollow structure model



CERASIC®-Bどおしの接合  
CERASIC-B bonded with CERASIC-B



CERASIC®-Bと  
CERASIC-BP(多孔質)との接合  
CERASIC-BP(porous)bonded  
with CERASIC-B

### ガス透過性(CERASIC®-B接合体)

#### 試験方法 Test model

